

BAREBONE XPC slim DH670

ROBUSTER 1,3-LITER SLIM PC UNTERSTÜTZT INTEL CORE PROZESSOREN MIT SOCKEL LGA1700 UND VIER UHD DISPLAYS

Das Shuttle XPC slim Barebone DH670 mit H670 Chipsatz bringt die Performance von Intels 12., 13. und 14. Generation** der Core Desktop-Prozessoren (Codename "Alder Lake-S" und "Raptor Lake-S [Refresh]") mit Socket LGA1700 ins kompakte 1,3-Liter Format. Es unterstützt den gleichzeitigen Betrieb von vier Ultra HD Displays über 2x HDMI und 2x DisplayPort. Dual-Intel-Netzwerk, vier USB 3.2 Gen 2 und COM-Ports sind ebenfalls vorhanden. Sein flaches Metallgehäuse mit VESA-Halterung, die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten und der zuverlässige Betrieb bei bis zu 50 °C Umgebungstemperatur machen das DH670 ideal für professionelle Anwendungsbereiche wie zum Beispiel Digital Signage, POS, POI, Spielautomaten, Büro, Gesundheitswesen und Industrie.



SLIM DESIGN

- Flaches 1,35-Liter Metallgehäuse, schwarz
- Abmessungen: 19 x 16,5 x 4,3 cm (LBH)
- Mit VESA-Halterung (75/100 mm)
- Unterstützt 24/7 Dauerbetrieb
- Betriebstemperatur: 0-50 °C (nicht kondensierend)

BETRIEBSSYSTEM

- Ein Betriebssystem ist nicht enthalten
- Unterstützt Windows 10, Windows 11 und Linux (64-Bit)

PROZESSOR SUPPORT **)

- Socket LGA1700 unterstützt Intel Core Prozessoren der 12./13./14. Generation "Alder Lake-S" und "Raptor Lake-S [Refresh]": Core i9/i7/i5/i3, Pentium Gold und Celeron, max. 65W TDP
- Heatpipe-Kühlsystem mit zwei Lüftern

GRAFIK

- Integrierte Intel HD-Grafik, unterstützt 4K (Eigenschaften hängen vom Prozessortyp ab)
- Unterstützt vier unabhängige UHD-Displays

CHIPSATZ

- Intel H670 Chipsatz

SPEICHER SUPPORT

- 2x 260-Pin SO-DIMM-Steckplatz
- Unterstützt DDR4-3200/2666/2400
- max. 2x 32 GB

LAUFWERKE- SATA / M.2

- 1x 2,5"-Schacht für SATA-Festplatte oder SSD
- 1x M.2-2280M Steckplatz (unterstützt PCIe 4.0 x4 NVMe oder SATA)
- 1x M.2-2230E Steckplatz für optionales WLAN-Modul

ANSCHLÜSSE

- 2x HDMI 2.0b
- 2x DisplayPort 1.4
- optional: VGA
- SD Cardreader
- 2x Audio (Mikrofon + Line-out)
- 4x USB 3.2 Gen2
- 4x USB 3.2 Gen1 (1x Typ-C)
- 1x USB 2.0 intern
- 2x Intel Gigabit LAN (RJ45)
- 2x COM-Port (1x RS232/422/485)
- Anschluss für externen Power-Button
- "Always-On" Jumper

POWER SUPPLY

- Externes 120W/19V Netzteil

OPTIONALES ZUBEHÖR

- WLAN Modul (WLN-M (ac)/WLN-M1 (ax))
- Standfuß (PS02)
- VGA-Anschluss (PVG01)
- Rackmount-Kit (PRM01)
- Kabel für externen Power Button (CXP01)
- Hutschienen-Montage-Kit (DIR01)
- LTE-Kit (WWN03)



MODELLE DER DH6xx-SERIE

Produkt	Chip	HDMI	DP	Displays	LAN (Intel)	M.2-2280 Slot	COM	Cardreader	DC-In	VESA Mount	UPC Code
DH610S	H610	1	1	max. 2 *)	1G	PCIe v3.0 X4	—	—	19V	—	887993005126
DH610	H610	1	2	max. 3	1G+2.5G	PCIe v3.0 X4	2	—	12V + 19V	enthalten	887993005119
DH670	H670	2	2	max. 4	2x 1G	PCIe v4.0 X4	2	Ja	19V	enthalten	887993004983
DH670V2	H670	2	2	max. 4	2x 2.5G	PCIe v4.0 X4	2	—	19V	enthalten	887993005942

*) max. 3 Displays mit dem optionalen VGA-Port (Zubehör PVG01)

** **Hinweis:** für Intel Core Prozessoren der 13./14. Generation (Raptor Lake-S [Refresh]) ist eventuell ein BIOS-Update notwendig, das mit einem kompatiblen Prozessor durchgeführt werden muß. Generation 13 wird seit BIOS-Version 205 unterstützt (verfügbar seit März'23) und Generation 14 wird seit BIOS-Version 210 unterstützt (verfügbar seit Jan'24).

LEISTUNGSMERKMALE



Robust, stilvoll und sehr klein

Man muss es selbst in der Hand gehalten haben, um zu merken, wie klein es wirklich ist. Das Stahlblechgehäuse verleiht diesem Slim-PC die nötige Stabilität für professionelle Anwendungen wie z.B. Digital Signage. Obwohl das Gehäuse für die gebotene Systemleistung mit nur 1,35 Litern sehr klein ist, wirkt der Aufbau nicht gedrängt, so dass die Installation leicht von der Hand geht. Dank seiner schlichten, stilvollen Optik wird es auch mancher stolzer Besitzer in seinem Büro oder zu Hause einsetzen.



Leise durch effizientes Heatpipe-Kühlsystem

Ein aktives Doppellüfter-Heatpipe-Kühlsystem gewährleistet größtmögliche Laufruhe und Systemstabilität.



Erweiterter Temperaturbereich und für Dauerbetrieb geeignet

Das Shuttle XPC slim Barebone DH670 ist offiziell für den 24-Stunden-Dauerbetrieb (24/7) freigegeben. Dank seiner niedrigen Verlustleistung und des fortschrittlichen Kühlsystems ist dieser PC besonders zuverlässig. Das eignet ihn ideal für Digital Signage und POI/POS-Anwendungen - auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 50 °C (nicht kondensierend). **Achtung:** Für hohe Umgebungstemperaturen ab 40 °C werden SSD-Laufwerke empfohlen.



Unterstützt Sockel LGA1700 Intel® Core™ Prozessoren *)

"Alder Lake-S" und „Raptor Lake-S (Refresh)" sind die Codenamen von Intels 12./13./14. Generation der Intel® Core™ Prozessoren mit Sockel LGA1700, die zusammen mit der 600/700er-Chipsatzserie vorgestellt wurden. Intel Prozessoren der 12000/13000/14000er Serie bieten ein Hybrid-Design mit einer bestimmten Anzahl von P-Kernen (hohe Performance) und E-Kernen (hohe Effizienz). Ob für Gamer, Kreative, Streamer oder alltägliche Benutzer – jetzt steht mehr Leistung dort zur Verfügung wo sie gebraucht wird.

*) ein BIOS-Update könnte erforderlich sein, um Gen13/14 zu unterstützen



Unterstützt vier UHD-Displays

Das DH670 bietet vier digitale Video-Ausgänge: zwei HDMI 2.0b und zwei DisplayPorts (DP 1.4), die jeweils ein 4K-Display mit 3840 x 2160 Ultra HD Auflösung (2160p) und 60Hz Bildwiederholfrequenz unterstützen. Darüber hinaus ist ein optionaler D-Sub/VGA-Ausgang möglich. Die



integrierte Grafik unterstützt maximal vier Displays gleichzeitig.

Ein M.2-Slot für SSD-Karten

Der M.2-2280M Steckplatz unterstützt M.2 SSD Flashspeicherkarten mit NVMe/PCIe V4.0 X4- oder SATA-Schnittstelle. Verwendete M.2-Steckkarten müssen 22 mm breit sein und können eine Länge von 42, 60 oder 80 mm (Typ 2242, 2260, 2280) haben.



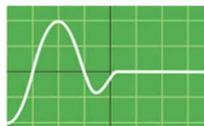
Dual Intel Gigabit Netzwerk

Das DH670 bietet zwei Netzwerkanschlüsse mit Intel Netzwerk-Adaptoren - diese sind bekannt für exzellente Performance und Treiber-Kompatibilität und werden in manchen professionellen Bereichen bevorzugt eingesetzt.



VESA-Halter

Mit der mitgelieferten 75/100mm-VESA-Halterung kann das DH670 an einer Wand, an einer Armhalterung oder hinter einem Monitor montiert werden, was speziell in Industrie, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen gefragt ist. Zahlreiche M3-Gewindeöffnungen im Gehäuse des PCs ermöglichen außerdem die Montage des DH670 an nahezu beliebigen Orten.



Einschalten nach Stromausfall

Die "Power-On after Power Fail"-Funktion im BIOS-Setup definiert, wie der PC nach einem Stromausfall reagiert: (1) unbedingt einschalten, (2) Status vor dem Stromausfall wiederherstellen (3) ausgeschaltet lassen (4) Einschalten über Netzwerk oder (5) Einschalten über Echtzeituhr (RTC). Prinzipbedingt kann diese Funktion jedoch bei sehr kurzen Stromausfällen versagen, so dass das DH670 zusätzlich über eine reine Hardwarelösung verfügt. Entfernt man Jumper JP2, dann startet der PC unbedingt, sobald die Stromversorgung hergestellt wird.



Externer Power-Button per Remoteleitung

Für den Fall, dass das Gerät durch räumliche Gegebenheiten (z. B. einen Festeinbau) nicht durch den frontseitig angebrachten Power-Button eingeschaltet werden kann, ist es per separater Remoteleitung startbar. Hierzu verbindet man einen Taster über die entsprechenden Pins im Backpanel des PCs. (Rastermaß: 2.54 mm). Außerdem stellt dieser Anschluss eine Clear CMOS Funktion bereit und liefert eine +5V DC Spannung für externe Geräte.

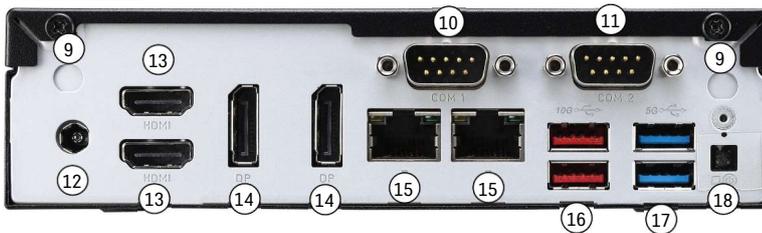
+5V voltage (2) (4) Power Button
Clear CMOS (1) (3) Ground

Vorder- und Rückansicht

Vorderseite



Rückseite



Rechts



Vorne

Hinten

Links



Hinten

Vorne

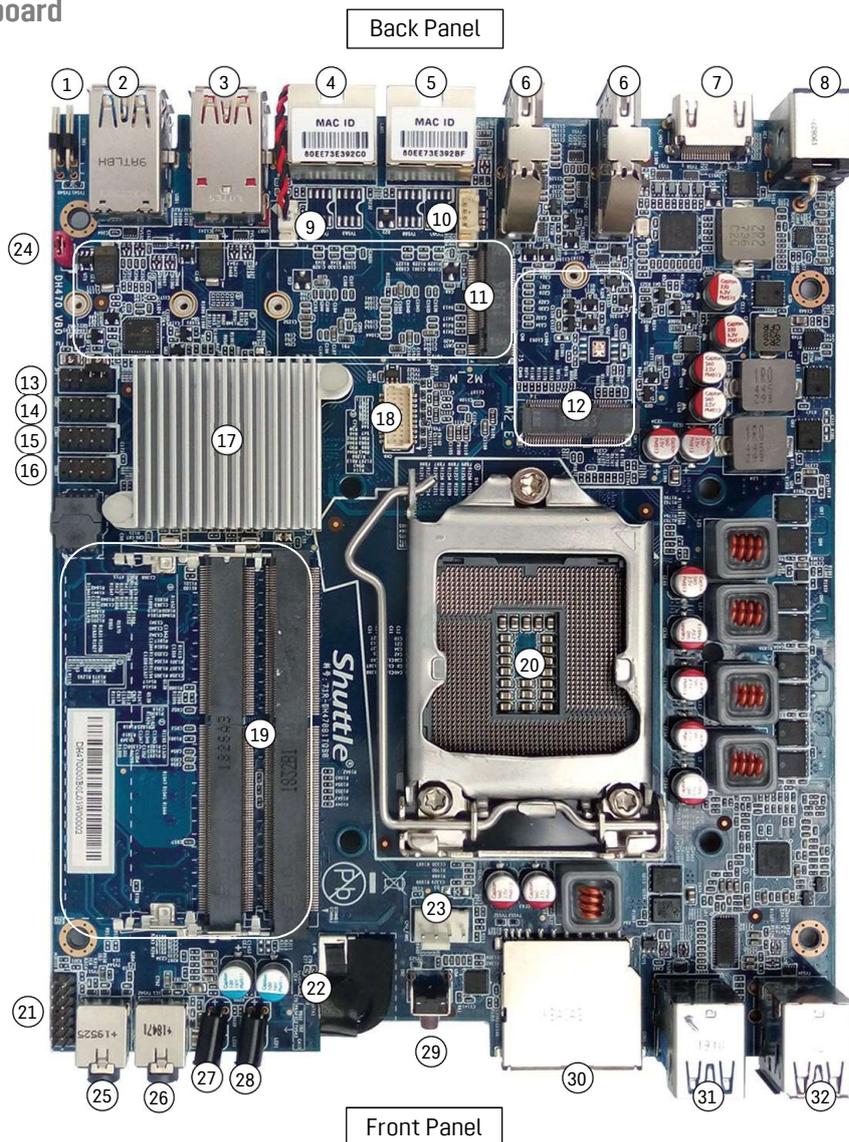


1. Mikrofon-Eingang
2. Kopfhörer-Ausgang
3. Betriebsanzeige-LED
4. Festplatten/SSD-LED
5. Ein-/Ausschalt-Button
6. SD Cardreader
7. 2x USB 3.2 Gen 1 Port (1x Typ-C)
8. 2x USB 3.2 Gen 2 Port
9. 2x WLAN Perforation
10. COM 1 unterstützt RS232/RS422/RS485
11. COM 2 unterstützt RS232 (oder optionaler VGA-Port für ein analoges Display)
12. DC-Anschluss für das externe Netzteil
13. 2x HDMI 2.0b Port
14. 2x DisplayPort 1.4
15. 2x RJ45 Gigabit LAN Port
16. 2x USB 3.2 Gen 2 Port
17. 2x USB 3.2 Gen 1 Port
18. Anschluss für externen Ein-/Aus-Button, Clear CMOS und 5 V DC (4 Pins mit 2,54 mm Rastermaß)

19. Löcher mit M3-Gewinde
20. 2x Öffnung für das Kensington-Lock

21. VESA-Halterung (zwei Teile)

Mainboard



Rückseite



Vorderseite



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 4-Pin-Anschluss für externen Ein-/Aus-Button, Clear CMOS und 5 V DC-Spannung (2,54 mm Rastermaß) 2. 2x USB 3.2 Gen 1 Port (1x Typ-C) 3. 2x USB 3.2 Gen 2 Port 4. RJ45 Gigabit LAN Port 5. RJ45 Gigabit LAN Port 6. 2x DisplayPort 1.2 7. HDMI 2.0a Port 8. DC-Anschluss für externes Netzteil 9. Anschluss für CMOS-Batterie 10. Onboard USB-2.0-Anschluss (4-Pin) 11. M.2-2280M Steckplatz für SSD-Karte 12. M2-2230E Steckplatz für WLAN-Karte 13. Jumper zur Einstellung der COM 1/2 Hilfsspannung (0/5/12 V) 14. Onboard COM 1 Port unterstützt RS232/RS422/RS485 15. Onboard COM 2 port unterstützt RS232 16. Debug-Anschluss (reserviert) | <ol style="list-style-type: none"> 17. Intel H670 Chipsatz mit Kühlkörper 18. Onboard VGA Anschluss 19. 2x SO-DIMM Speichersteckplatz 20. LGA1700 Prozessorsocket 21. Audio-Anschlüsse (optional) 22. SATA v3.0 Anschluss 23. 4-Pin Anschluss für den Prozessorlüfter 24. Always-Power-On Jumper 25. Mikrofon-Eingang 26. Kopfhörer-Ausgang 27. Betriebsanzeige-LED 28. Festplatten/SSD-LED 29. Ein-/Ausschalt-Button 30. SD Cardreader 31. 2x USB 3.2 Gen 1 Port 32. 2x USB 3.2 Gen 2 Port |
|---|---|

BENÖTIGTE KOMPONENTEN

Es werden nur wenige Komponenten benötigt, um einen lauffähigen Mini-PC zu erhalten:

Shuttle XPC slim Barebone DH670



LGA1700 Prozessor

Intel Core Gen 12/13/14 "Alder Lake-S" oder "Raptor Lake-S"
Core i9 / i7 / i5 / i3, Pentium Gold oder Celeron
TDP max. 65 W

***)** ein BIOS-Update könnte erforderlich sein, um Gen13/14 zu unterstützen



Speichermodule

Ein oder zwei Speichermodule:
DDR4-3200/2666/2400 SO-DIMM
jeweils max. 32 GB



2,5" Laufwerk

Festplatte oder SSD im 2,5"-Format
(max. Bauhöhe: 12,5 mm)



M.2 SSD (optional)

M.2-2280/2260/2242
SSD-Modul (SATA or PCIe/NVMe)



Betriebssystem

Windows 10/11 oder Linux (nur 64-Bit)

OPTIONALES ZUBEHÖR VON SHUTTLE



VGA-Port-Adapter **PVG01**

Der Einbau von PVG01 ersetzt eine serielle Schnittstelle (COM-Port) im Backpanel.



Standfuß **PS02**

für den vertikalen Betrieb



WLAN-Kit

WLN-M (802.11ac / Wifi 5)

WLN-M1 (802.11ax / Wifi 6)

Die M.2-2230-Karte unterstützt WLAN und Bluetooth
Enthält 2 Antennen



Hutschienen-Kit **DIR01**

ermöglicht die Montage auf einer Standard 35-mm-Hutschiene



LTE Adapter Kit **WWN03**

ermöglicht die Installation einer M.2-LTE-Karte und einer nano SIM Karte (dabei wird der 2,5"-Schacht belegt)



Rackmount-Kit **PRM01**

2HE-Blende für Einbau von zwei 1,3L-Shuttle-XPCs in einen 19" Schrank



Kabel **CXP01**

Anschlusskabel für einen externen Power-Button (ohne Button)

Produktvergleich: 4xx-Serie versus 6xx-Serie

MODELL	DH410S	DH410(C)	DH470(C)	DH610S	DH610	DH670(V2)
PROZESSOR SUPPORT	Intel Core, Socket LGA1200, TDP max. 65 W Codename "Comet Lake-S" – Gen 10			Intel Core, Socket LGA1700, TDP max. 65 W Codename "Alder Lake-S"/"Raptor Lake-S" – Gen 12/13/14 **)		
CHIPSATZ	Intel H410	Intel H410	Intel H470	Intel H610	Intel H610	Intel H670
BETRIEBSSYSTEM	Windows 10/11 und Linux (64-Bit)			Windows 10/11 und Linux (64-Bit)		
MULTI-DISPLAY	max. 2	max. 2	max. 3	max. 2 **)	max. 3	max. 4
RAM-SPEICHER	max. 2x 32 GB DDR4-2933/2666 SO-DIMM			max. 2x 32 GB DDR4-3200 /2666 SO-DIMM		
2,5"-SCHACHT	1x 2,5" Laufwerksschacht, SATA-Anschluss max. Laufwerkshöhe: 12,5 mm			1x 2,5" Laufwerksschacht, SATA-Anschluss max. Laufwerkshöhe: 12,5 mm		
M.2-2280 SSD SLOT	M.22280M unterstützt PCIe 3.0 x4 oder SATA			PCIe 3.0 x4 oder SATA	PCIe 3.0 x4 oder SATA	PCIe 4.0 x4 oder SATA
WLAN SLOT	M.2-2230E			M.2-2230E		
BUTTONS / LEDS	Power-Button, Power LED, HDD LED			Power-Button, Power LED, HDD LED		
SD CARDREADER	Ja, jedoch nicht bei DH410C und DH470C			Nein	Nein	Ja, nur DH670
GRAFIKPORTS	HDMI 1.4b DP 1.2	HDMI 2.0a DP 1.2	HDMI 2.0a 2x DP 1.2	HDMI 2.0b DP 1.4	HDMI 2.0b 2x DP 1.4	2x HDMI 2.0b 2x DP 1.4
USB 3.2 GEN. 2	–	–	4	–	–	4
USB 3.2 GEN. 1	4 (1x Typ-C)	4	4 (1x Typ-C)	4 (1x Typ-C)	4 (1x Typ-C)	4 (1x Typ-C)
USB 2.0	4	4	–	4	4	–
COM PORTS	–	2	2	–	2	2
GIGABIT NETZWERK	Single LAN Realtek 8111H (1G)	Dual LAN 2x Intel 210 (1G)	Dual LAN 2x Intel 210 (1G)	Single LAN Intel 219V/LM (1G)	Dual LAN Intel 225 (2.5G) Intel 219V/LM (1G)	Dual LAN 2x i210/211 (1G) DH670V2: 2x 2.5G
AUDIO	Mikrofon-Eingang, Line-Out (Realtek ALC662)			Mikrofon-Eingang, Line-Out (Realtek ALC662/897/888S)		
OPTIONALES ZUBEHÖR	WLAN-Kit: WLN-M/WLN-M1 Standfuß: PS02 , VGA-Port-Adapter: PVG01 Power Button Kabel: CXP01 Rackmount-Kit: PRM01 , Hutschienen-Kit: DIR01 LTE-Kit: WWN03			WLAN-Kit: WLN-M/WLN-M1 Standfuß: PS02 , VGA-Port-Adapter: PVG01 Power Button Kabel: CXP01 Rackmount-Kit: PRM01 , Hutschienen-Kit: DIR01 LTE-Kit: WWN03		
VESA-HALTER	optional PV04	mitgeliefert	mitgeliefert	optional PV04	mitgeliefert	mitgeliefert
NETZTEIL	90 W / 19 V			120 W / 19 V		
DC-IN 12V SUPPORT	–	Ja	–	–	Ja	–

Produktbilder



*) DH410C und DH470C haben keinen Cardreader eingebaut. **) DH610S unterstützt drei Displays, falls ein VGA-Port eingebaut wird (Zubehör PVG01)

**) Wichtiger Hinweis für Shuttle XPCs der DH6xx/XH61x-Serie: für Intel Core Prozessoren der 13./14. Generation (Raptor Lake-S [Refresh]) ist möglicherweise ein BIOS-Update erforderlich, das zuvor mit einem kompatiblen Prozessor durchgeführt werden muß.

SHUTTLE XPC SLIM BAREBONE DH670 – SPEZIFIKATION

GEHÄUSE	<p>Slim PC mit schwarzem Metallgehäuse</p> <p>Abmessungen: 19 x 16,5 x 4,3 cm (LBH) = 1,35 Liter</p> <p>Gewicht: 1,3 kg netto und 2,1 kg brutto</p> <p>Zwei Öffnungen für Kensington Lock und zahlreiche M3-Gewindeöffnungen an beiden Gehäuseseiten.</p>
NETZTEIL	<p>Externes 120 W Netzteil (lüfterlos)</p> <p>Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz</p> <p>Ausgang: 19 V DC, 6,32 A, max. 120 W</p> <p>DC-Stecker: 5,5/2,5 mm (Außen/Innen-Durchmesser)</p> <p>Hinweis: Der DC-Eingang des Computers unterstützt eine externe Spannungsversorgung mit 19V±5%</p> <p>AC-Kabel: 3-polig, ca. 1,7 m lang, mit C5/C6 Kleeblatt-Steckverbindung zum Netzteil und CEE-7/7 Stecker mit Schutzkontakt (Typ E+F) für den Anschluss an die Steckdose</p>
BETRIEBSSYSTEM	<p>Dieses System wird ohne Betriebssystem ausgeliefert.</p> <p>Es ist kompatibel mit Windows 10/11 und Linux (64 Bit).</p>
PROZESSOR-UNTERSTÜTZUNG	<p>Prozessor Socket LGA1700</p> <p>Unterstützt Intel Core i9 / i7 / i5 / i3, Pentium Gold und Celeron Prozessoren</p> <p>Unterstützt folgende Generationen Intel Core Prozessoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gen 12 "Alder Lake-S" - Gen 13 "Raptor Lake-S" seit BIOS-Version 205 verfügbar seit März'23 *) - Gen 14 "Raptor Lake-S Refresh" seit BIOS-Version 210 verfügbar seit Jan'24 *) <p>in "Intel 7" Prozesstechnologie (ehemals: Intel 10 nm Enhanced SuperFin)</p> <p>Unterstützt nur Prozessoren mit integrierter Grafikfunktion [5]</p> <p>Maximal unterstützte Prozessor-Verlustleistung (TDP) = 65 W.</p> <p>Unterstützt nicht die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie.</p> <p>Der Prozessor integriert die Controller für PCI-Express und Speicher und die Grafikfunktion auf dem gleichen Halbleiter-Chip</p> <p>*) Achtung: falls ein BIOS-Update notwendig ist, dann muß der PC zunächst mit einem kompatiblen Prozessor gestartet werden.</p> <p>Download-Website: https://global.shuttle.com/support/download</p>
PROZESSOR-KÜHLUNG	<p>Heatpipe-Prozessor-Kühlung mit zwei 60-mm-Lüftern auf der Gehäuseseite</p>
MAINBOARD / CHIPSATZ	<p>Mainboard im Shuttle-Format - spezielles Design für XPC Barebone DH670</p> <p>Chipsatz/Southbridge: Intel® H670</p> <p>Passive Chipsatz-Kühlung mit Kühlkörper</p> <p>Die Northbridge ist im Prozessor integriert.</p> <p>Mit Feststoffelektrolytkondensatoren (Solid Capacitors) - diese Kondensatoren sind hitzebeständiger und langlebiger.</p>
BIOS	<p>AMI BIOS, SPI-Interface, 16 MB Flash-EEPROM-Baustein</p> <p>Unterstützt Hardware-Überwachung und Watchdog-Funktion</p> <p>Unterstützt Firmware-TPM (fTPM) v2.0 [9]</p> <p>Unterstützt Booten vom externem Flashspeicher über USB</p> <p>Unterstützt das Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)</p> <p>Unterstützt Neustart nach Stromausfall (Power-On-after-Power-Fail) [7]</p>
SPEICHER-UNTERSTÜTZUNG	<p>2x SO-DIMM-Steckplatz mit 260 Pins</p> <p>Unterstützt DDR4-3200/2933/2666/2400/2133 (PC4-25600/23466/21300/19200/17000) SDRAM mit 1,2 V</p> <p>Unterstützt Dual-Channel-Modus</p> <p>Unterstützt maximal 32 GB pro Steckplatz</p> <p>Gesamtkapazität maximal 64 GB</p> <p>Unterstützt unbuffered DIMM-Module (kein ECC oder registered)</p>
INTEGRIERTE GRAFIKFUNKTION	<p>Die Eigenschaften der integrierten Intel UHD Grafikfunktion hängen vom verwendeten Prozessortyp ab. [10]</p> <p>Der PC bietet vier Video-Ausgänge, die 1080p/60 und 2160p/60 unterstützen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x HDMI v2.0b - 2x DisplayPort v1.4 <p>Unterstützt 4K-Displays mit 3840 x 2160 Ultra HD Auflösung</p> <p>Unterstützt vier unabhängige Displays über die integrierte Grafikfunktion</p> <p>DisplayPort und HDMI unterstützen Multikanal Digital Audio über das gleiche Kabel.</p> <p>Optionaler analoger D-Sub/VGA-Videoausgang [4]</p>
LAUFWERKSSCHACHT	<p>1x 6,35 cm / 2,5" Laufwerksschacht für eine Festplatte oder ein SSD-Laufwerk mit SATA-Anschluss</p> <p>Laufwerkshöhe 12,5 mm (max.)</p>

SATA-ANSCHLUSS	1x Serial-ATA III, 6 Gb/s (600 MB/s) Datentransferrate Mit Serial-ATA Stromanschluss (onboard)
M.2-2280M SSD -STECKPLATZ	Der M.2 2280M Steckplatz bietet folgende Schnittstellen: - PCI-Express Gen. 4.0 X4 unterstützt NVMe - SATA v3.0 (max. 6 Gbit/s) Verwendete M.2-Steckkarten müssen 22 mm breit sein und können eine Länge von 42, 60 oder 80 mm (Typ 2242, 2260, 2280) haben. Unterstützt M.2 SSDs mit SATA- oder PCI-Express-Schnittstelle
M.2-2230E- STECKPLATZ FÜR WLAN-KARTEN	Schnittstellen: PCI-Express Gen. 2.0 X1 und USB 2.0 Verwendete M.2-2230-Steckkarten müssen 22 mm breit und 30 mm lang sein (Typ 2230) Unterstützt WLAN-Erweiterungskarten (Optionales Shuttle-Zubehör: WLN-M, WLN-M1)
SOUNDFUNKTION	Audio Realtek® ALC 897/662/888S High-Definition Audio Zwei analoge 3,5 mm Audio-Anschlüsse auf der Vorderseite: 1) 2-Kanal Line-out (Kopfhörer) 2) Mikrofon-Eingang Digitale Multikanal-Audio-Ausgabe über HDMI und DisplayPort
DUAL GIGABIT NETZWERK- CONTROLLER	Zwei RJ45 Netzwerkanschlüsse mit jeweils zwei Status-LEDs Verwendete Netzwerkchips: 2x Intel i210/i211 Ethernet Controller (MAC+PHY) PCIe-Schnittstelle Unterstützt Windows 10 Desktop und Windows Server Betriebssystem Unterstützt 10 / 100 / 1.000 MBit/s Datentransferrate Unterstützt WAKE ON LAN (WOL) Unterstützt das Booten vom Netzwerk via Preboot eXecution Environment (PXE)
CARDREADER	Integrierter Cardreader zum Auslesen und Beschreiben von SD, SDHC und SDXC bis zu V3.01 Flash-Speicherkarten UHS-I-Interface unterstützt bis zu 104 MB/s (SDR104) Transferrate PCIe Chipsatz-Anbindung
ANSCHLÜSSE VORDERSEITE	Mikrofon-Eingang Audio Line-out (Kopfhörer) 2x USB 3.2 Gen 2 Typ A (Rot) 1x USB 3.2 Gen 1 Typ A (Blau) 1x USB 3.2 Gen 1 Typ C SD Cardreader Ein/Aus-Button Betriebsanzeige-LED (Blau) Festplatten-LED (Gelb)
ANSCHLÜSSE RÜCKSEITE	2x HDMI 2.0b Anschluss [1] 2x DisplayPort 1.4 Anschluss (DP) [2] Optional: 1x D-Sub VGA Anschluss (Zubehör PVG01 [4]) 2x USB 3.2 Gen 2 Typ A (Rot) 2x USB 3.2 Gen 1 Typ A (Blau) 2x Gigabit LAN (RJ45) 2x RS232 serieller Port, 9-pol. D-Sub (5/12V, 1x RS422/RS485) [3] 1x DC-Eingang für externes Netzteil (unterstützt 19V±5%) 1x 4-Pin-Anschluss (2,54 mm Rastermaß) unterstützt: - externen Einschalt-Taster - Clear CMOS Funktion - 5V DC Spannung für externe Komponenten 2x Perforation für optionale Wireless-LAN-Antennen 2x Öffnung für Kensington Lock
WEITERE ONBOARD- ANSCHLÜSSE	1x Jumper für Power-On-after-Power-Fail (Hardware-Lösung) [7] 1x analoger VGA Grafikausgang CN6 (2x10 Pins, 1 mm Pitch) [4] 2x serielle Schnittstelle (COM) belegt für Backpanel-Anschlüsse 1x USB 2.0 (4 Pins) für optionales Zubehör WWN03 (LTE-Kit) 1x Lüfteranschluss (4 Pins) belegt durch das Kühlsystem 1x Anschluss für CMOS-Batterie (belegt)

LIEFERUMFANG	<p>Mehrsprachige Installationsanleitung (DE, EN, FR, ES, JP, KR, SC, TC) VESA-Halterung für 75/100mm-Standard (zwei Metallwinkel) Vier Schrauben M3 x 5 mm (verbindet VESA-Halter mit PC) Vier Schrauben M4 x 10 mm (verbindet VESA-Halter mit externer Befestigung) Vier Schrauben M3 x 4 mm (zur Montage eines 2,5"-Laufwerks) Zwei Schrauben M3 x 5 mm (silberfarben, zum Befestigen von zwei M.2-Karten) Treiber-DVD (Windows 64 Bit) Serial-ATA-Kabel für 2,5"-Laufwerk mit Stromanschluss Externes 120W-Netzteil mit Netzanschlusskabel Schutzkappe für den CPU-Sockel (nicht verwenden, falls Heatpipe oder Kühler installiert sind) Wärmeleitpaste</p>
OPTIONALES ZUBEHÖR	<p>PVG01: Optionaler D-Sub VGA Video-Ausgang [4] WLN-M/M1: WLAN-Modul im M.2-2230-Format mit zwei externen Antennen unterstützt WLAN und Bluetooth WWN03: LTE-Adapter-Kit mit Antennen, jedoch ohne LTE-Karte [8] PS02: Standfüße für den vertikalen Betrieb CXP01: Adapterkabel für einen externen Power-Button PRM01: 2HE-Rackblende für zwei Shuttle XPC slim PCs DIR01: Hutschienen-Montage-Kit</p>
UMGEBUNGS-PARAMETER	<p>Zulässiger Betriebstemperaturbereich: 0-50 °C [6] Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend: 10-90 %</p>
ZERTIFIKATE / KONFORMITÄT	<p>EMI: FCC, CE, BSMI, RCM, VCCI Sicherheit: CB, BSMI, ETL Weitere: RoHS, Energy Star, ErP</p>
KONFORMITÄT	<p>Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) (2) Richtlinie 2014/35/EU über die Sicherheit von elektrischen Betriebsmitteln (LVD) (3) Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP)

[1] HDMI-Ausgang unterstützt DVI mit optionalem Adapter

[2] DisplayPort in HDMI/DVI konvertieren

Der DisplayPort Ausgang kann mit einem günstigen, passiven Adapterkabel in HDMI oder DVI konvertiert werden. Zum Beispiel:

DELOCK 82590: 1 m, DisplayPort (männl., 20P) zu HDMI-A (männl., 19P)

DELOCK 82435: 5 m, DisplayPort (männl., 20P) zu DVI-D (männl., 24P)

Die integrierte Grafikfunktion erkennt die Eigenschaft des angeschlossenen Displays und gibt das passende elektrische Signal aus - entweder DisplayPort (ohne Adapter) oder HDMI/DVI (mit Adapter).

Umgekehrt kann ein Bildschirm mit DisplayPort nicht über einen einfachen, passiven Adapter an den HDMI-Ausgang angeschlossen werden.

[3] Serielle Schnittstellen

Dieser PC verfügt über zwei serielle RS232 Schnittstellen mit 9-poligen D-Sub-Anschlüssen auf der Rückseite. Der linke COM-Port (COM1) kann im BIOS-Setup auch auf RS422- und RS485-Modus umgeschaltet werden.

Pin 9 der D-Sub COM-Port-Anschlüsse ist ein multifunktionaler Anschluss. Mit dem Mainboard-Jumper JP1 lässt sich konfigurieren, ob Pin 9 als "Ring Indicator" (RI) geschaltet ist oder eine externe Spannungsversorgung von 5V bzw. 12V bietet. Jeder COM-Port ist einzeln konfigurierbar. Der maximale Strom beträgt 500 mA pro Anschluss.

[4] Optionaler D-Sub/VGA-Ausgang

Das Mainboard verfügt über einen analogen Grafikausgang CN6 auf dem Mainboard. Dieser kann über einen optionalen Adapter (PVG01) als 15-poliger D-Sub-Anschluss nach außen geführt werden. Hierbei wird eine serielle Schnittstelle (COM-Port) im Backpanel ersetzt. Die integrierte Grafik unterstützt maximal vier Displays gleichzeitig.

[5] Nicht kompatibel sind Intel Prozessoren ohne integrierte Grafikfunktion erkennbar an dem Buchstaben "F" in der Prozessorbezeichnung, z.B. Core i7-12700F.

[6] Betriebstemperatur

Für hohe Umgebungstemperaturen ab 40 °C werden SSD-Laufwerke (bis zu 70 °C) und SO-DIMM-Speicher mit erweitertem Temperaturbereich (bis zu 95 °C) empfohlen.

[7] Power-On-after-Power-Fail

Im BIOS-Setup unter "Power Management Configuration" befindet sich die Funktion "Power-On-after-Power-Fail", womit definiert wird wie der PC nach einem Stromausfall reagiert: (1) unbedingt einschalten, (2) Status vor dem Stromausfall wiederherstellen oder (3) ausgeschaltet lassen. Prinzipbedingt kann diese Funktion jedoch bei sehr kurzen Stromausfällen versagen, so dass das DH670 zusätzlich über eine reine Hardwarelösung verfügt. Entfernt man Jumper JP2 (auf dem Mainboard hinter dem Einschalt-Button), dann startet der PC unbedingt, sobald die Stromversorgung hergestellt wird.

[8] Optionales Zubehör WWN03 (LTE-Kit)

Mit Hilfe des Shuttle XPC accessory WWN03 Zubehör-Kits können Sie diesen PC mit einer LTE/4G-Funktion für mobiles Netzwerk ausstatten. Hierbei wird der 2,5"-Schacht für den Einbau der LTE-Karte belegt, so dass als Massenspeicher eine SSD im M.2-Format notwendig ist. Ein LTE-Modul im M.2-3042-Format und eine Nano-SIM-Karte sind weiterhin erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten.

[9] TPM-Funktion

Dieses Produkt verfügt bereits über ein Firmware-TPM (fTPM) v2.0. Es ist außerdem für einen Hardware-TPM-Chip vorbereitet, so dass es auf Sonderbestellung im Werk bestückt werden kann.

12. GENERATION DER INTEL CORE DESKTOP PROZESSOR-FAMILIE

Socket LGA1700 10 nm "Alder Lake S" Prozessorübersicht (Datum: Januar 2022)

Prozessoren mit TDP > 65 W und Prozessoren ohne Grafikfunktion ("F"-Kennung) werden **nicht unterstützt (rot hinterlegt)**

PROZESSOR	MODELL	P-CORES/ THREADS	P-CORES TAKT/Turbo	E-CORES	E-CORES TAKT/Turbo	SMART CACHE	BASE TDP	SPEICHER SUPPORT	GRAFIKFUNKTION (MAX. TAKT)
Core™ i9	12900K	8 / 16	3,2 – 5,1 GHz	8	2,4 – 3,9 GHz	30 MB	125 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.55 GHz)
	12900KF	8 / 16	3,2 – 5,1 GHz	8	2,4 – 3,9 GHz	30 MB	125 W	DDR4-3200	Nicht vorhanden
	12900	8 / 16	2,4 – 5,0 GHz	8	1,8 – 3,8 GHz	30 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.55 GHz)
	12900F	8 / 16	2,4 – 5,0 GHz	8	1,8 – 3,8 GHz	30 MB	65 W	DDR4-3200	Nicht vorhanden
	12900T	8 / 16	1,4 – 4,8 GHz	8	1,0 – 3,6 GHz	30 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.55 GHz)
Core™ i7	12700K	8 / 16	3,6 – 4,9 GHz	4	2,7 – 3,8 GHz	25 MB	125 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.50 GHz)
	12700KF	8 / 16	3,6 – 4,9 GHz	4	2,7 – 3,8 GHz	25 MB	125 W	DDR4-3200	Nicht vorhanden
	12700	8 / 16	2,1 – 4,9 GHz	4	1,6 – 3,6 GHz	25 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.50 GHz)
	12700F	8 / 16	2,1 – 4,9 GHz	4	1,6 – 3,6 GHz	25 MB	65 W	DDR4-3200	Nicht vorhanden
	12700T	8 / 16	1,4 – 4,6 GHz	4	1,0 – 3,4 GHz	25 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.50 GHz)
Core™ i5	12600K	6 / 12	3,7 – 4,9 GHz	4	2,8 – 3,6 GHz	20 MB	125 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.45 GHz)
	12600KF	6 / 12	3,7 – 4,9 GHz	4	2,8 – 3,6 GHz	20 MB	125 W	DDR4-3200	Nicht vorhanden
	12600	6 / 12	3,3 – 4,8 GHz	-	-	18 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.45 GHz)
	12600T	6 / 12	2,1 – 4,6 GHz	-	-	18 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.45 GHz)
	12500	6 / 12	3,0 – 4,6 GHz	-	-	18 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.45 GHz)
	12500T	6 / 12	2,0 – 4,4 GHz	-	-	18 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.45 GHz)
	12400	6 / 12	2,5 – 4,4 GHz	-	-	18 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 730 (1.45 GHz)
	12400F	6 / 12	2,5 – 4,4 GHz	-	-	18 MB	65 W	DDR4-3200	Nicht vorhanden
	12400T	6 / 12	1,8 – 4,2 GHz	-	-	18 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 730 (1.45 GHz)
Core™ i3	12300	4 / 8	3,5 – 4,4 GHz	-	-	12 MB	60 W	DDR4-3200	UHD 730 (1.45 GHz)
	12300T	4 / 8	2,3 – 4,2 GHz	-	-	12 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 730 (1.45 GHz)
	12100	4 / 8	3,3 – 4,3 GHz	-	-	12 MB	60 W	DDR4-3200	UHD 730 (1.45 GHz)
	12100F	4 / 8	3,3 – 4,3 GHz	-	-	12 MB	58 W	DDR4-3200	Nicht vorhanden
	12100T	4 / 8	2,2 – 4,1 GHz	-	-	12 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 730 (1.40 GHz)
Pentium® Gold	G7400	2 / 4	3,7 GHz	-	-	6 MB	46 W	DDR4-3200	UHD 710 (1.35 GHz)
	G7400T	2 / 4	3,1 GHz	-	-	6 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 710 (1.35 GHz)
Celeron®	G6900	2 / 2	3,4 GHz	-	-	4 MB	46 W	DDR4-3200	UHD 710 (1.30 GHz)
	G6900T	2 / 2	2,8 GHz	-	-	4 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 710 (1.30 GHz)

K = unlocked: einstellbarer Takt-Multiplikator, **T** = stromsparend, **F** = ohne integrierte Grafikfunktion, **TDP** = Thermal Design Power (max. Verlustleistung).

Hinweise: Das Shuttle XPC slim Barebone DH670 unterstützt nicht die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie.

P-Cores: Performance-Cores (leistungsstarke Prozessorkerne), E-Cores: Efficient-Cores (effiziente Prozessorkerne)

Core Clock: es werden Basis- und Turbo-Frequenzen genannt (die Turbo Boost 3.0-Frequenz wird hier nicht genannt)

Base TDF: maximale Prozessor-Verlustleistung, der bei der Basis-Frequenz nicht überschritten wird (Max. Turbo Power wird hier nicht genannt)

Detaillierte Informationen über kompatible Prozessoren finden Sie in der Support-Liste unter global.shuttle.com.

13. GENERATION DER INTEL CORE DESKTOP PROZESSOR-FAMILIE

Socket LGA1700 10 nm Intel 7 / 10 nm, "Raptor Lake S" Prozessorübersicht (Datum: Januar 2023)

Prozessoren mit **TDP>65 W** und **Prozessoren ohne Grafikkfunktion ("F"-Kennung)** werden **nicht unterstützt (rot hinterlegt)**

Wichtiger Hinweis: für Intel Core Prozessoren der 13. Generation ("Raptor Lake-S") und der 14. Generation ("Raptor Lake-S Refresh") ist eventuell ein BIOS-Update notwendig, das mit einem kompatiblen Prozessor durchgeführt werden muß.

- Generation 13 wird seit BIOS-Version 205 unterstützt (verfügbar seit März'23) und

- Generation 14 wird seit BIOS-Version 210 unterstützt (verfügbar seit Jan'24).

Download-Website: <https://global.shuttle.com/support/download>.

PROZESSOR	MODELL	P-CORES/ THREADS	P-CORES TAKT/Turbo	E-CORES	E-CORES TAKT/Turbo	SMART CACHE	BASE TDP	SPEICHER SUPPORT	GRAFIKFUNKTION (MAX. TAKT)
Core™ i9	13900K	8 / 16	3,2 – 6,0 GHz	16	2,4 – 4,3 GHz	36 MB	150 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.65 GHz)
	13900K	8 / 16	3,0 – 5,8 GHz	16	2,0 – 4,3 GHz	36 MB	125 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.65 GHz)
	13900KF	8 / 16	3,0 – 5,8 GHz	16	2,0 – 4,3 GHz	36 MB	125 W	DDR4-3200	Nicht vorhanden
	13900	8 / 16	2,0 – 5,2 GHz	16	1,5 – 4,2 GHz	36 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.65 GHz)
	13900F	8 / 16	2,0 – 5,2 GHz	16	1,5 – 4,2 GHz	36 MB	65 W	DDR4-3200	Nicht vorhanden
	13900T	8 / 16	1,1 – 5,1 GHz	16	0,8 – 3,9 GHz	36 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.65 GHz)
Core™ i7	13700K	8 / 16	3,4 – 5,4 GHz	8	2,5 – 4,2 GHz	30 MB	125 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.60 GHz)
	13700KF	8 / 16	3,4 – 5,4 GHz	8	2,5 – 4,2 GHz	30 MB	125 W	DDR4-3200	Nicht vorhanden
	13700	8 / 16	2,1 – 5,1 GHz	8	1,5 – 4,1 GHz	30 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.60 GHz)
	13700F	8 / 16	2,1 – 5,1 GHz	8	1,5 – 4,1 GHz	30 MB	65 W	DDR4-3200	Nicht vorhanden
	13700T	8 / 16	1,4 – 4,8 GHz	8	1,0 – 3,6 GHz	30 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.60 GHz)
Core™ i5	13600K	6 / 12	3,5 – 5,1 GHz	8	2,6 – 3,9 GHz	20 MB	125 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.50 GHz)
	13600KF	6 / 12	3,5 – 5,1 GHz	8	2,6 – 3,9 GHz	20 MB	125 W	DDR4-3200	Nicht vorhanden
	13600	6 / 12	2,7 – 5,0 GHz	8	2,0 – 3,7 GHz	24 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.55 GHz)
	13600T	6 / 12	1,8 – 4,8 GHz	8	1,3 – 3,4 GHz	24 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.55 GHz)
	13500	6 / 12	2,5 – 4,8 GHz	8	1,8 – 3,5 GHz	24 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.55 GHz)
	13500T	6 / 12	1,6 – 4,6 GHz	8	1,2 – 3,2 GHz	24 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.55 GHz)
	13400	6 / 12	2,5 – 4,6 GHz	4	1,8 – 3,3 GHz	20 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 730 (1.55 GHz)
	13400F	6 / 12	2,5 – 4,6 GHz	4	1,8 – 3,3 GHz	20 MB	65 W	DDR4-3200	Nicht vorhanden
Core™ i3	13400T	6 / 12	1,3 – 4,4 GHz	4	1,0 – 3,0 GHz	20 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 730 (1.55 GHz)
	13100	4 / 8	3,4 – 4,5 GHz	-	-	12 MB	60 W	DDR4-3200	UHD 730 (1.50 GHz)
	13100F	4 / 8	3,4 – 4,5 GHz	-	-	12 MB	58 W	DDR4-3200	Nicht vorhanden
	13100T	4 / 8	2,5 – 4,2 GHz	-	-	12 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 730 (1.50 GHz)

K = unlocked: einstellbarer Takt-Multiplikator, T = stromsparend, F = ohne integrierte Grafikkfunktion, TDP = Thermal Design Power (max. Verlustleistung).

Hinweise: Das Shuttle XPC slim Barebone DH670 unterstützt nicht die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie.

P-Cores: Performance-Cores (leistungsstarke Prozessorkerne), E-Cores: Efficient-Cores (effiziente Prozessorkerne)

Core Clock: es werden Basis- und Turbo-Frequenzen genannt (die Turbo Boost 3.0-Frequenz wird hier nicht genannt)

Base TDF: maximale Prozessor-Verlustleistung, der bei der Basis-Frequenz nicht überschritten wird (Max. Turbo Power wird hier nicht genannt)

Detaillierte Informationen über kompatible Prozessoren finden Sie in der Support-Liste unter global.shuttle.com.

14. GENERATION DER INTEL CORE DESKTOP PROZESSOR-FAMILIE

Socket LGA1700 10 nm Intel 7 / 10 nm, "Raptor Lake S Refresh" Prozessorübersicht (Datum: Januar 2024)

Prozessoren mit **TDP>65 W** und **Prozessoren ohne Grafikkfunktion ("F"-Kennung)** werden **nicht unterstützt (rot markiert)**

Wichtiger Hinweis: für Intel Core Prozessoren der 13. Generation ("Raptor Lake-S") und der 14. Generation ("Raptor Lake-S Refresh") ist eventuell ein BIOS-Update notwendig, das mit einem kompatiblen Prozessor durchgeführt werden muß.

- Generation 13 wird seit BIOS-Version 205 unterstützt (verfügbar seit März'23) und

- Generation 14 wird seit BIOS-Version 210 unterstützt (verfügbar seit Jan'24).

Download-Website: <https://global.shuttle.com/support/download>.

PROZESSOR	MODELL	P-CORES/ THREADS	P-CORES TAKT/Turbo	E-CORES	E-CORES TAKT/Turbo	SMART CACHE	BASE TDP	SPEICHER SUPPORT	GRAFIKFUNKTION (MAX. TAKT)
Core™ i9	14900K	8 / 16	3,2 – 5,6 GHz	16	2,4 – 4,4 GHz	36 MB	125 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,65 GHz)
	14900KF	8 / 16	3,2 – 5,6 GHz	16	2,4 – 4,4 GHz	36 MB	125 W	DDR4-3200	Nicht vorhanden
	14900	8 / 16	2,0 – 5,4 GHz	16	1,5 – 4,3 GHz	36 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,65 GHz)
	14900F	8 / 16	2,0 – 5,4 GHz	16	1,5 – 4,3 GHz	36 MB	65 W	DDR4-3200	Nicht vorhanden
	14900T	8 / 16	1,1 – 5,1 GHz	16	0,8 – 4,0 GHz	36 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,65 GHz)
Core™ i7	14700K	8 / 16	3,4 – 5,6 GHz	8	2,5 – 4,3 GHz	33 MB	125 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,60 GHz)
	14700KF	8 / 16	3,4 – 5,6 GHz	8	2,5 – 4,3 GHz	33 MB	125 W	DDR4-3200	Nicht vorhanden
	14700	8 / 16	2,1 – 5,3 GHz	8	1,5 – 4,2 GHz	33 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,60 GHz)
	14700F	8 / 16	2,1 – 5,4 GHz	8	1,5 – 4,2 GHz	33 MB	65 W	DDR4-3200	Nicht vorhanden
	14700T	8 / 16	1,3 – 5,0 GHz	8	0,9 – 3,7 GHz	33 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,60 GHz)
Core™ i5	14600K	6 / 12	3,5 – 5,3 GHz	8	2,6 – 4,0 GHz	24 MB	125 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,50 GHz)
	14600KF	6 / 12	3,5 – 5,3 GHz	8	2,6 – 4,0 GHz	24 MB	125 W	DDR4-3200	Nicht vorhanden
	14600	6 / 12	2,7 – 5,2 GHz	8	2,0 – 3,9 GHz	24 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,55 GHz)
	14600T	6 / 12	1,8 – 5,1 GHz	8	1,3 – 3,6 GHz	24 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,55 GHz)
	14500	6 / 12	2,6 – 5,0 GHz	8	1,9 – 3,7 GHz	24 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,55 GHz)
	14500T	6 / 12	1,7 – 4,8 GHz	8	1,2 – 3,4 GHz	24 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,55 GHz)
	14400	6 / 12	2,5 – 4,7 GHz	4	1,8 – 3,5 GHz	20 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 730 (1,55 GHz)
	14400F	6 / 12	2,5 – 4,7 GHz	4	1,8 – 3,5 GHz	20 MB	65 W	DDR4-3200	Nicht vorhanden
	14400T	6 / 12	1,5 – 4,5 GHz	4	1,1 – 3,2 GHz	20 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 730 (1,55 GHz)
Core™ i3	14100	4 / 8	3,5 – 4,7 GHz	-	-	12 MB	60 W	DDR4-3200	UHD 730 (1,50 GHz)
	14100F	4 / 8	3,5 – 4,7 GHz	-	-	12 MB	58 W	DDR4-3200	Nicht vorhanden
	14100T	4 / 8	2,7 – 4,4 GHz	-	-	12 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 730 (1,50 GHz)

K = unlocked: einstellbarer Takt-Multiplikator, T = stromsparend, F = ohne integrierte Grafikkfunktion, TDP = Thermal Design Power (max. Verlustleistung).

Hinweise: Das Shuttle XPC slim Barebone DH670 unterstützt nicht die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie.

P-Cores: Performance-Cores (leistungsstarke Prozessorkerne), E-Cores: Efficient-Cores (effiziente Prozessorkerne)

Core Clock: es werden Basis- und Turbo-Frequenzen genannt (die Turbo Boost 3.0-Frequenz wird hier nicht genannt)

Base TDF: maximale Prozessor-Verlustleistung, der bei der Basis-Frequenz nicht überschritten wird (Max. Turbo Power wird hier nicht genannt)

Detaillierte Informationen über kompatible Prozessoren finden Sie in der Support-Liste unter global.shuttle.com.